

正面



側面



特長

3つの技術を採用し、品質事故リスクを 極限まで低減した高い品質と耐久性を実現

1. パラジウムめっきフレーム使用で、高い耐久性を実現

一般的には製品完成後に半田めっきを行います。完成後めっきでは、めっき液が侵入し、品質事故につながる可能性があります。弊社製品は、プレめっきのため、その恐れがありません。

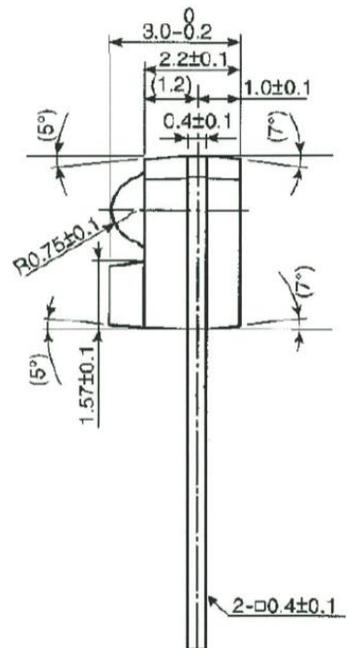
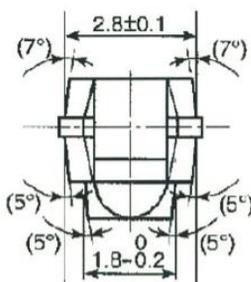
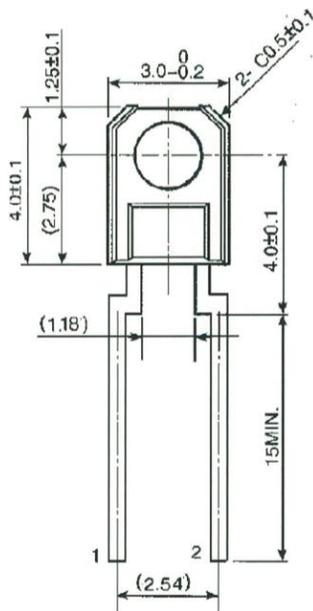
2. 低温アッセンブリで、部材酸化による品質劣化なし

低温速硬化ダイボンドにより、チップ・フレーム・樹脂の高密着性を実現しています。またフレームの酸化防止・不純物の折出低減による高いボンディング品質により、部材酸化による品質劣化がありません。

3. 高信頼の樹脂/構造の採用

高信頼性モールド樹脂、減圧でボイドレスのモールド、2重構造による劣化防止パッケージで、品質劣化を防止。

外形



ピン接続図

1. カソード
2. アノード

※ () は参考値

定格及び特性

絶対最大定格

Ta=25°C

項目	記号	定格	単位
直流順電流	I _f	50	mA
パルス順電流 *1	I _{fp}	600	mA
直流順電流低減率 (Ta>25°C)	ΔI _f /°C	-0.33	mA/°C
直流逆電圧	V _r	5	V
動作温度	T _{opr}	-30 ~ +95	°C
保存温度	T _{stg}	-40 ~ +100	°C
はんだ付け温度 *2	T _{sol}	260	°C

*1: パルス幅≤100μs、繰り返し周波数=100Hz

*2: 端子根元より2mm以上

電氣的及び光学的特性

Ta=25°C

項目	記号	条件	MIN	TYP	MAX	単位
順電圧	V _F	I _F =10mA	1.0	1.15	1.30	V
逆電流	I _R	V _R =5V	-	-	10	μA
放射強度	I _E	I _F =20mA	5	17.5	30	mW/sr
光出力	P _O	I _F =20mA	-	2.5	-	mW
端子間容量	C _T	V _R =0、f=1MHz	-	30	-	pF
ピーク発光波長	λ _p	I _F =20mA	-	940	-	nm
スペクトル半値幅	Δλ	I _F =20mA	-	50	-	nm
半値角	θ _{1/2}	I _F =20mA	-	±15	-	°

